



半导体行业 2023 年度策略 报告：但行“芯”路 不问 “硅”期



平安观点：

“硅周期”和宏观经济周期等多种因素叠加，行业在 2023 年有望探底：

由于宏观经济下行、地缘政治冲突、疫情蔓延等因素影响，加上本轮的移动互联网和 IT 基础设施建设的“硅周期”进入尾声，行业下行压力凸显。

从宏观经济走势以及下游应用发展来看，我们预计行业有希望在 2023 年见到周期底部，年内有可能完成去库存，2024 年有望恢复增长。

下行周期看赛道，关注新能源汽车、新能源以及研发设计类仪器仪表等领域：1) 半导体加速“上车”，供需偏紧的格局还在持续。一方面，新能源汽车中半导体器件获得显著的增量需求，单车半导体价值量已翻倍；另一方面，我们看到新能源汽车渗透率的大幅度提升。整体芯片需求依然旺盛，包括功率器件、碳化硅、MCU 和模拟芯片依然还是需求增长的重点。2) “风光储”装机量快速增长拉动功率半导体需求，而且受益于国内整机厂和零部件厂的集聚，国内相关领域的功率半导体企业也获得比较大的市场机会；3) 设计研发类仪器仪表也迎来替代高峰，国家连续出台鼓励性政策，国内电子测量仪器厂商能力较快提升，替代空间在逐步打开。

投资建议：半导体设计端依然延续着需求分化的格局，新能源车和新能源等大赛道仍有机会，功率半导体、第三代半导体、MCU 和模拟芯片等

都面临着巨大的市场机会，尤其是供给偏紧、供应链割裂的大环境下，市场机会凸显，推荐斯达半导、时代电气、纳芯微、圣邦股份、兆易创新等标的；研发设计端除了 EDA 工具之外，仪器仪表自主化也需要发力，建议关注鼎阳科技和坤恒顺维。半导体行业作为国家重点关注和支持的战略性新兴产业，虽然短期内回调较为明显，但中长期发展潜力巨大，而且国内在多个领域也正在突破。首次覆盖该行业，给予行业“强于大市”评级。

风险提示：1) 美国制裁风险上升；2) 政策支持力度不及预期；3) 市场需求可能不及预期；4) 国产替代不及预期。

关键词：新能源 新能源汽车 疫情 碳化硅 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49850

